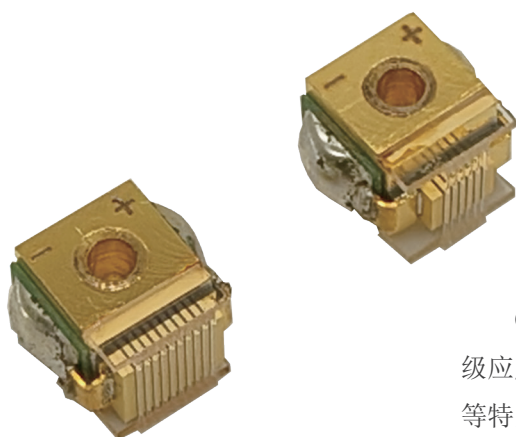


# GS06传导冷却 半导体激光器阵列



GS06封装形式的半导体激光器阵列是杏林睿光开发的一款微秒级应用的器件。该款器件具有结构紧凑，功率密度高，发光面积小等特点。

## 主要功能特点

- ◆ 硬焊料封装
- ◆ 结构紧凑
- ◆ 高峰值功率密度
- ◆ 高可靠性

## 应用

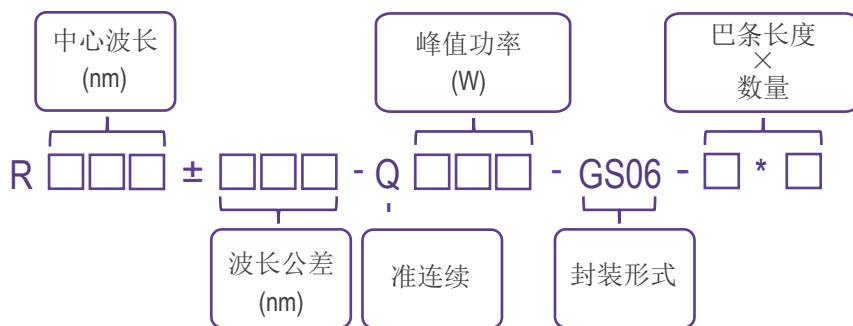
泵浦源  
科学研究

## 技术参数

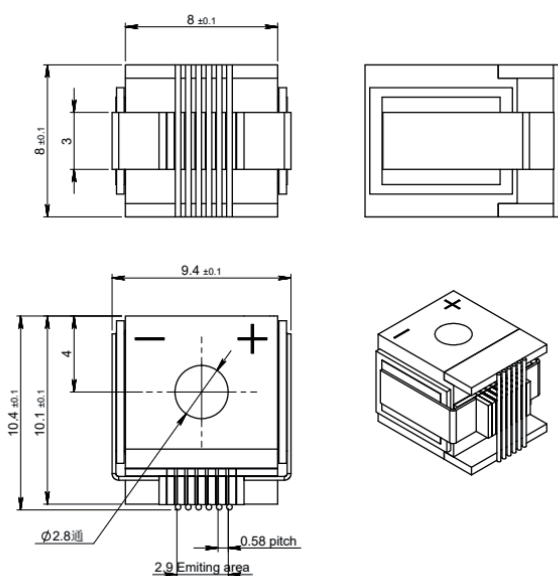
光学参数		
型号	R808±5-Q900-GS06-3*6-001	R808±5-Q1800-GS06-5*9-001
中心波长 $\lambda_c$ (nm)	808	
中心波长范围 $\delta\lambda_c$ (nm)	±5	
每Bar输出功率 (W)	150	200
Bar数量	6	9
Bar间距 (mm)	~0.6	
光谱宽度 (FWHM) (nm)	<5	
每Bar斜率效率(W/A)	>1.0	
快轴发散角 (FWHM) (°)	8	
慢轴发散角 (FWHM) (°)	12	
波长温度漂移系数 (nm/°C)	~0.3	
电学参数		
电光转换效率 (%)	>48	
阈值电流 $I_{th}$ (A)	<27	<27
工作电流 $I_{op}$ (A)	<170	<170
工作电压 $V_{op}$ (V)	<2	
占空比 (%)	<0.8	
脉冲宽度 ( $\mu$ s)	<300	
重复频率 (Hz)	<30	
热学参数		
工作温度范围 (°C)	0~45	
储存温度范围 (°C)	0~55	

1. 不同参数请咨询销售经理。
2. 如果超过正常工作范围使用，器件寿命可能会缩短。
3. 器件工作或储存环境需保证不结露。
4. 以上参数测试条件：QCW。

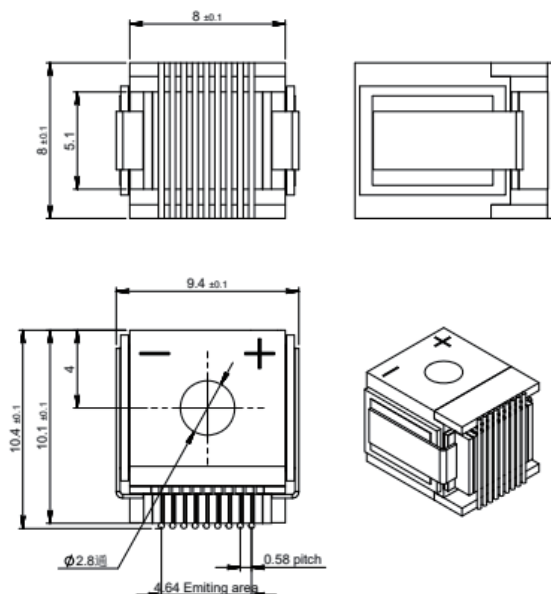
## 产品型号命名规则



## 机械尺寸图 单位：mm



R808±5-Q900-GS06-3\*6



R808±5-Q1800-GS06-5\*9

